1. PLD:可编程逻辑器件，包括PROM、PLA、PAL、GAL、FPGA、CPLD等。
2. EDA:电子设计自动化
3. CAD:计算机辅助设计
4. HDL:硬件描述语言
5. FPGA（Field Programmable Gate Array）:现场可编程门阵列，高密度，主要由三部分组成：可配置逻辑块（CLB），输入输出模块（IOB）和布线通道。
6. CPLD:复杂可编程逻辑器件，高密度，可多次编程、改写和擦除。
7. ISP:在系统编程
8. DTL:二极管晶体逻辑电路
9. TTL:逻辑门电路
10. MOS:金属—氧化物—半导体场效应晶体管
11. ASIC:专用型集成电路
12. PROM:可编程ROM，低密度，内部的**或**阵列可编程，与阵列和输出电路固定，其编程数据只能写一次。
13. PLA:可编程逻辑阵列，低密度，内部的**或**阵列和**与**阵列可编程，输出电路固定，其编程数据只能写一次。
14. PAL:可编程阵列逻辑，低密度，内部的**与**阵列可编程，或阵列和输出电路固定，其编程数据只能写一次。
15. GAL:通用阵列逻辑，低密度，采用电可擦除的E2CMOS工艺。
16. OLMC:输出逻辑宏单元
17. LAB:逻辑阵列块
18. EPT:扩展乘积项
19. PIA:可编程阵列连线
20. IOC:输入输出控制块
21. PSM:可编程开关矩阵
22. PI:可编程互连线
23. CLB:可配置逻辑块
24. RTL:寄存器转换级电路
25. SSI:小规模集成电路
26. MSI:中规模集成电路
27. LSI:大规模集成电路
28. VLSI:超大规模集成电路
29. 触发器：JKFF、RSFF、DFF（由时钟沿触发、同步控制）、TFF
30. BUFF:恒等